

『最先端の半導体製造に求められる超精密金型設計技術および放電加工技術』

半導体製造で求められる超精密金型設計技術および放電加工技術をテーマに「第3回高付加価値加工技術セミナー」を開催します。

日本初の半導体・LED・電子部品封止金型のファブレスメーカーとして、「日本の半導体産業復活」をテーマに全世界のニーズに合った高精度金型を提供する株式会社 CAPABLE と、半導体業界における封止金型加工に不可欠となる放電加工機を中心に、独自の技術力と商品開発力を活かした高精度放電加工システムを提供する三菱電機株式会社を講師に迎え、最新情報をお話いただきます。

半導体業界への進出のヒント満載のセミナーとなっていますので、皆様の積極的なご参加をお待ちしています。

- 開催日時： 令和6年12月16日(月) 13:30～17:00
- 会 場： サンピーチ岡山 3F ピーチホール（岡山市北区駅前町2丁目3番31号）
- 内 容：（各項目には、講師紹介＋質疑応答の時間を含みます）

時 間	項 目
13:30～15:00	セミナー① 「半導体産業の現状と将来、及び半導体封止金型について」 講師・株式会社 CAPABLE 代表取締役社長 河原 洋逸 氏 《講演概要》 一時世界の50%超も掌握していた日本の半導体産業が過去 30 年にわたり凋落の一途をたどってきましたが、昨今半導体は経済安保の要として日本政府の積極的なサポートもあり、再び盛り返す機運が醸成されています。 その中で高度な超精密加工を必要とする半導体封止金型の内容を詳細に説明し、新規参入の可能性検討の一助にさせていただきたいです。
15:00～15:15	休憩
15:15～16:45	セミナー② 「三菱電機が提供する超精密放電加工技術のご紹介」 講師・三菱電機株式会社 放電システム部 加工技術課 足立 慶貴 氏 《講演概要》 近年、半導体市場の規模拡大に伴い半導体封止金型の需要増加が見込まれます。半導体封止金型の製作には形彫放電加工機が使用され、離形性向上を目的とし高精度な加工と高品位な加工面が要求されています。当社形彫放電加工機 SV-P シリーズの最新技術による前述の要求への対策と加工事例を紹介します。
16:45～17:00	名刺交換

- 参加費用： 無料（先着：40名）
- 主 催： 岡山県 ＜委託先：(公財)岡山県産業振興財団＞
- 申込締切： 令和6年12月11日（水） 17:00
- 申込方法： 参加申込書に必要事項をご記入の上、事務局宛てに FAX またはメールでお申込みください。尚、下記 URL もしくは QR コードからお申し込みいただけます。

https://www.optic.or.jp/okayama-ssn/event_detail/index/3391.html

